

1-6-1-4 CF 接着剤残り残銅／CF 粘性物の残余銅／Residual copper by carrier-film adhesive residue

【特徴】UTC の残留CF 接着剤下の残銅

【特征】在UTC 的CF 残留黏结剂下面的残余铜。

【Characteristics】Residual copper under a remaining carrier-film adhesive on UTC

【原因・判断ポイント・発生工程】積層条件の不適合などによりUTC のCF 剥離時にUTC 銅箔側に残った接着物が、ET レジストとなった為出来たもの（UTC 積層～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于层压条件不合适等，UTC 的CF 剥落时在UTC 侧残留的粘性物成为ET 剂而引起的（UTC 层压～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

An adhesive left on UTC foil at the time of carrier-film stripping due to improper lamination condition acts as an etching resist to cause the defect. (UTC lamination - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×175

【注釋】
显微镜倍率×175

【Comments】
Magnification: ×175



【コメント】
顕微鏡倍率×175

【注釋】
显微镜倍率×175

【Comments】
Magnification: ×175

1-6-1-5 積層板樹脂中残銅／层压板树脂中的残余铜／Residual copper in laminate

【特徴】積層板樹脂層の中に残っている銅屑状残銅

【特征】在层压板树脂中残留的铜屑的残余铜。

【Characteristics】Copper debris remaining in a laminate

【原因・判断ポイント・発生工程】積層板製造過程で、銅屑が積層板樹脂中に紛れ込んで出来たもの（積層板製造工程）

【原因、判断要点、发生工序】在层压板制造过程铜屑混入树脂中而引起的（层压板制造工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

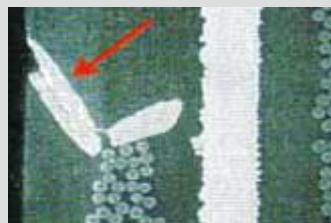
A copper debris is carelessly entrapped in a laminate in CCL manufacturing process to cause the defect. (CCL manufacturing process)



【コメント】
樹脂付き銅箔樹脂中の
残銅
顕微鏡倍率×

【注釋】
背胶銅箔中の残余銅
显微镜倍率×

【Comments】
Residual copper in
resin coated copper
foil.
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×300

【注釋】
显微镜倍率×300

【Comments】
Magnification: ×300